

鉛フリー対応水溶性プレフラックス タフエースF2 無電解銀めっき SSP-700

■ タフエースF2 標準品

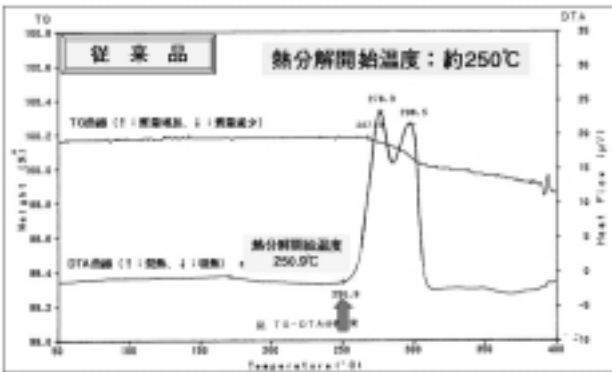
タフエースF2(LX) 銅一金混載基板用
新製品 タフエースF2(PK) 半導体パッケージ基板用

【概要】

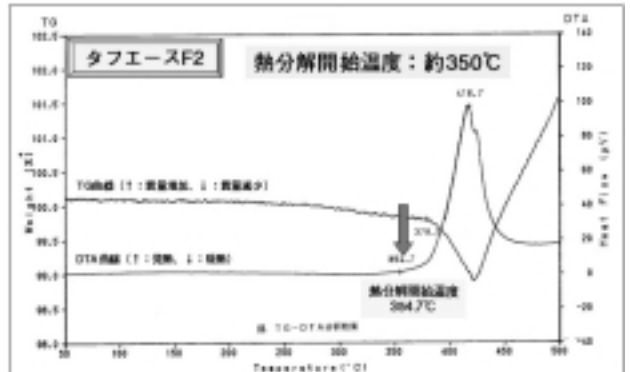
鉛フリー対応水溶性プレフラックス「タフエースF2」はプリント基板の銅表面処理剤（防錆剤）として鉛フリーはんだでの実績が増加中です。従来の水溶性プレフラックスと比較して熱分解温度が高いのが特長で、特に鉛フリー化に伴い、HAL代替の表面処理としても注目されています。また、新製品の半導体パッケージ基板用のF2（PK）は高温長時間のベーキングを行っても銅の酸化が少ない塗膜を形成します。

【特長】

- 従来品より熱分解温度が高いのはんだ付け性に優れています。
- 接合強度に優れています。
- イオン残渣が少ないです。
- 金属めっきと比較してコストダウンになります。



従来品の膜の熱分析結果



タフエースF2膜の熱分析結果

■ 無電解銀めっき SSP-700

【概要】

プリント基板の総合表面処理メーカーの四国化成は銀めっきを開発しました。無電解銀めっき（SSP-700）は、耐硫化水素ガス、耐マイグレーションに優れており、従来の銀めっきの欠点を克服している材料です。

【特長】

- 置換型の銀めっきです。
- 耐マイグレーション・電氣的信頼性に優れています。
- ガス（硫化水素）腐食試験で変色が殆どありません。
- はんだ付け性に優れています。

【特性】

評価項目	条件	結果
はんだ広がり性	60°C/95%RH/96Hr トリフロ-3回目 Sn-3.0Ag-0.5Cu	印刷径の2倍以上の広がり性
はんだ揚がり性	60°C/95%RH/96Hr トリフロ-3回後 Sn-3.0Ag-0.5Cu	スルーホールアップ率 100%
マイグレーション試験	IPC-A型くし型電極 85°C/85%RH/DC50V/1000Hr	マイグレーション発生なし
耐湿負荷絶縁抵抗値	IPC-A型くし型電極 85°C/85%RH/DC50V/1000Hr	>10 ¹⁰ Ω

四国化成工業株式会社

〒261-8501
千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB16
Tel : 043-296-4104 Fax : 043-350-3580
E-mail fukudah@shikoku.co.jp